



重庆市人民政府办公厅 关于印发《重庆市集成电路封测产业发展 行动计划（2023—2027年）》的通知

渝府办发〔2023〕110号

各区县（自治县）人民政府，市政府各部门，有关单位：

《重庆市集成电路封测产业发展行动计划（2023—2027年）》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市人民政府办公厅

2023年12月29日

（此件公开发布）



重庆市集成电路封测产业发展行动计划

(2023—2027年)

为进一步提升我市集成电路产业封测能力，形成集成电路产业闭环，建设更具竞争力的集成电路产业集群，助力打造“33618”现代制造业集群体系，结合我市实际，制定本行动计划。

一、总体要求

(一) 发展思路及路径。

持续优化集成电路封测产业生态，加快集聚壮大市场主体，超前布局先进封测未来方向，推动全市集成电路封测产业做大做强、提升能级，为我市制造业高质量发展提供有力支撑。

——强化上下游配套，壮大封测产业规模。增强晶圆代工能力，吸引封测企业聚集，壮大 OSAT（委外半导体封测）企业规模。依托市内化工基础，提升材料、框架等下游产品配套能力，孵化培育一批本土封测装备、材料企业。

——强化应用牵引，做精特色封测产业。发挥我市智能网联新能源汽车、电子信息等支柱产业的牵引作用，构建特色封测研

发及服务体系，孵化培育一批功率半导体、硅光芯片、MEMS（微机电系统）传感器龙头封测企业。

——紧扣技术发展趋势，布局先进封测产业。加大招商引资力度，引进一批先进封测企业来渝落地发展。加快先进封测技术研发及创新平台建设，鼓励在渝企业开展先进封测技术布局。

（二）发展目标。

到 2027 年，全市集成电路封测产业营收突破 200 亿元；新增集成电路封测企业 10 家以上，其中营收超过 5 亿元的企业 2 家以上；化合物半导体、功率半导体、硅光芯片、MEMS 传感器封测水平全国领先；集成电路封测能力对支柱产业的支撑能力显著增强，建成具有重要国际影响力的集成电路封测产业集群。

二、重点任务

（一）培育壮大封测市场主体。

1. 持续壮大传统封测企业规模。大力支持我市总部型封测企业做大规模、提升工艺水平及服务能力，推动我市现有封测龙头企业上市融资，提高市场竞争力及影响力。对接引进国内外封测龙头企业，带动集聚一批封测企业来渝落地发展。鼓励我市集成电路产业链上游的设计、制造龙头企业发挥引领作用，招引一批封测企业来渝配套发展。支持独立测试分析服务企业或机构做



大做强，与大型封装企业形成互补。〔责任单位：市经济信息委、市招商投资局，有关区县（自治县，以下简称区县）政府〕

2. 培育壮大特色封测企业。强化应用场景牵引，面向智能网联新能源汽车、电子信息、先进制造等支柱产业，重点围绕特色芯片高可靠性、定制外形的封测需求，积极培育车规级汽车芯片、功率半导体、硅光芯片、MEMS 传感器等特色封测企业。支持特色封测企业持续开展工艺升级、技术迭代、验证优化，打造一批“专精特新”“小巨人”企业。鼓励引导特色封测企业与终端用户企业联合开展特色芯片最终测试验证，研究制定封测标准，发挥对封测产业的示范、引领、带动作用。（责任单位：市经济信息委、市国资委、市市场监管局、市招商投资局，有关区县政府）

3. 加快引进先进封测龙头企业。大力吸引国内外封测龙头企业来渝建设先进封装测试生产线，支持存量企业提升先进封测研发制造能力，抢占未来封测产业发展制高点。支持先进封测技术研发中心建设，加大晶圆级、系统级、模块级等先进封测核心技术研发创新力度。聚焦先进封测需求，加大研发创新支持力度，通过“揭榜挂帅”“赛马比拼”等方式开展核心技术攻关。（责任单位：市经济信息委、市科技局、市市场监管局、市招商投资



局，有关区县政府)

(二) 延伸产业链条。

4. 推进封测环节融合拓展。支持先进封测、特色封测向集成电路设计和制造等中上游环节延伸融合发展，开发高效协同的异质异构集成技术。支持模组生产企业向前端芯片封测业务拓展、芯片封测企业向后端模组生产业务延伸，打造更加完备的集成电路下游制造环节。(责任单位：市科技局、市经济信息委，有关区县政府)

5. 拓展封测产业前端需求。大力争取晶圆代工龙头和高端设计企业来渝布局，鼓励 IDM (垂直整合制造) 企业对外开放制造产能、委外半导体封测，扩大封测产业前端需求，壮大集成电路封测产业规模，显著增强产业链竞争力，带动集成电路设计、制造、封测、材料、设备全面发展。(责任单位：市发展改革委、市经济信息委、市招商投资局，有关区县政府)

6. 加快完善封测后端配套产业。依托我市化工产业基础，加快封装基板、引线框架等封装材料研发与产业化进程，实现材料本土化生产，降低封装材料成本。大力引进和培育技术领先的集成电路封测设备企业，鼓励封测企业和设备企业共同研发特色封测设备，强化封测相关设备保障。(责任单位：市经济信息委、



市招商投资局，有关区县政府）

（三）加快完善产业发展生态。

7. 优化园区承载环境。调整优化存量园区规划布局，在交通物流便利、产业配套齐备的区域打造封测企业集聚区。出台利用存量园区发展封测产业的配套措施，加快实施收储改造，打造适合封测企业入驻的园区载体。简化入驻流程，对新入驻的封测企业给予租金减免、购房装修、水电气讯等政策支持。（责任单位：有关区县政府）

8. 打造一站式公共服务平台。建设集成电路快速封装、检测认证等公共服务平台，面向中小微封测企业提供封测技术研发、试用验证、仿真测试、创新应用等服务。鼓励 IDM 企业对外开放封装测试能力。引导检验检测龙头企业面向中小微企业拓展集成电路封测业务领域。（责任单位：市经济信息委、市国资委、市市场监管局，有关区县政府）

9. 着力培育封测技能型人才。统筹各类院校、企业等资源，鼓励企业、高校及行业协会合作建设集教育、培训及研究于一体的封测人才培养平台，大力培养封测技能型人才。引导行业协会组织牵头开展技能培训、技术交流等活动，提高重庆集成电路封测产业人才专业化技能。强化人力资源政策向封测产业倾斜，对

封测技能型人才培养培训、招工用工给予补贴。（责任单位：市教委、市人社局，有关区县政府）

10. 强化金融扶持。充分运用重庆产业投资母基金发展集成电路产业，鼓励支持有条件的区县设立集成电路封测产业引导资金，推动集成电路封测产业生态培育和重大项目引进工作。积极探索产业基金投资新模式，促进产业与资本深度融合。鼓励各类金融机构加大对集成电路封测企业的信贷支持力度，支持金融机构推出符合集成电路封测企业融资需求的信贷创新产品。（责任单位：市国资委、人行重庆市分行、国家金融监督管理总局重庆监管局，有关区县政府）

三、保障措施

（一）加强组织领导。

充分发挥重庆市高新技术产业工作专班（办公室设在市发展改革委）作用，统筹推进全市集成电路封测产业发展，督促推动相关项目落地建设，定期督导评估相关政策落实和任务完成情况。强化市、区县协调联动，有关区县政府要明确工作目标、工作任务、进度安排和保障措施，共同推动本行动计划各项任务落实。（责任单位：市发展改革委、市经济信息委、市科技局、市财政局、市国资委，有关区县政府）



(二) 加大政策支持力度。

1. 企业培育支持方面。对实际到位投资在 5 亿元以上的集成电路封测类企业,按照企业贷款利息(中国人民银行基准利率) 50%的比例,给予最高不超过 2000 万元的贴息支持。对开放产能为行业企业提供封装测试服务的集成电路封装测试企业,按照封测费用 5%的比例给予资金支持,对单个企业年度支持总额最高不超过 200 万元。鼓励有条件的区县对年度营收首次有较大突破的集成电路先进封测企业予以一定奖励。(责任单位:市经济信息委,有关区县市政府)

2. 平台建设支持方面。对为封测企业提供芯片测试与验证等公共服务的市级集成电路公共服务平台,根据平台运行服务情况,按不超过企业运营费的 10%给予奖励,对单个企业的奖励资金每年最高不超过 400 万元。支持有条件的区县建设集成电路产业集群公共服务综合体,并根据项目总投资规模给予一定比例或者额度的补助。(责任单位:市经济信息委,有关区县市政府)

(三) 加强企业服务保障。

强化土地厂房支持,对集成电路封测产业项目新增建设用地的,优先保障用地指标。切实保障集成电路封测企业对电、水、气等生产要素的需求,对符合条件的企业纳入直供电交易范畴。(责任单位:市经济信息委、市规划自然资源局,有关区县市政府)